

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

诺德新材料股份有限公司
关于参加 2026 年吉林辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2026 年 5 月 19 日（周二）下午 15:00-16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	陈立志（董事长） 王寒朵（副总经理兼董事会秘书） 王丽雯（首席财务官） 蔡明星（独立董事） 程楚楚（证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 在“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参加“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络远程的方式与投资者进行了交流，本次投资者集体接待日的主要问答情况如下：

1、公司的产品已通过比亚迪和宁德时代的认证并批量生产了吗

尊敬的投资者，您好，公司与比亚迪、中创新航、亿纬锂能、孚能科技、宁德时代（CATL）、宁德新能源（ATL）、国轩高科、LG 化学、SK on 等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定，不断夯实锂电铜箔领域的市场地位。感谢您的关注。

2、请问公司 3m 极薄铜箔量产进度及客户导入情况如何？固态电池配套铜箔研发测试进展怎样，后续产能与盈利提升规划是什么？

尊敬的投资者，您好。公司已率先实现 3 μ m 和 3.5 μ m 极薄铜箔规模化量产，成为行业内少数能稳定量产该规格产品的企业，延续了公司在极薄铜箔领域的先发优势。公司正逐步构建起全系列极薄铜箔产品矩阵，凭借差异化产品策略有效规避行业低端价格竞争，聚焦下游头部客户高端产品需求。公司自 2018 年起研发出多孔铜箔，目前公司研发的多孔铜箔适用于固态电池，能够进一步优化电池性能，提高充放电效率和能量密度。2025 年 10 月，公司作为行业内首发推出的耐高温双面镀镍合金箔实现重要技术升级，该产品有效解决了硫化物固态电解质腐蚀难题，同时能够应对高比例硅碳负极应用中氢氟酸浓度上升带来的腐蚀挑战。2025 年 11 月，镀镍合金箔凭借颠覆性创新斩获 2025（第十五届）高工金球奖年度创新技术/产品奖项。感谢您的关注与支持！

3、公司市值才一百多亿，2026 年综合授信高达 260 亿，若 260 亿对外担保借款实现，贷款利息即财务费用约是多少？

尊敬的投资者，您好。公司会根据实际生产经营资金需求，尽量以低利率向有关金融机构进行融资。感谢您的关注与支持！

4、资产负债率 65.85%，一年内到期短债约 64 亿，现金仅 44 亿，财务总监有何具体降杠杆计划？

尊敬的投资者，您好。公司 2026 年一季度末，有应收账款债权凭证等已贴现或者保理但不满足终止确认条件的约 11 亿元计入了短期借款，此部分的应收账款债权凭证到期终止确认不用再支付现金。公司下一步降

低财务杠杆的措施有：一是优化债务结构，减少短期债务，增加长期债务；二是加快应收账款的回收，收紧信用政策，减少部分客户的账期；三是继续加大高附加值产品的生产和销售，提高公司的盈利能力，同时公司内部继续挖潜，降本增效；四是引进战略投资者，增加权益资本。感谢您的关注与支持！

5、公司目前高端电子电路铜箔的产能为3万吨，后续有进一步加大电子电路铜箔占比计划吗？如扩产到5万吨，设备有何掣肘？

尊敬的投资者，您好。公司目前使用的自研的国产设备进行高端电子电路铜箔的生产，后续如需扩产，设备不存在掣肘问题。感谢您的关注！

6、董事长好！公司总部已搬离吉林，东北的营商环境如此和办事效率都无法与沿海发达地区相提并论，为什么证券监管还在东北？不转到深圳？

尊敬的投资者，公司注册地仍在吉林，监管属地按注册地划分暂无法变更。目前经营与管理总部已落地深圳，日常经营、市场开拓全面贴合沿海区位优势。感谢您的关注。

7、公司的产品已通过谷歌的认证并批量生产了吗

尊敬的投资者，您好。谷歌不是我们的直接客户，不对公司产品进行认证。感谢您的关注。

8、对于公司未来的发展，我是极度看好，但总担忧，因公司信息违规披露及财务，负债率高了。高端电子铜箔二季度以及到年底产能会有多少，相对应的供给哪些核心公司呢？谢谢

尊敬的投资者，您好。公司正规范信披、压降负债率、优化财务结构。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延锂电铜箔、高端电子电路箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端PCB等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！

9、董事长你好，目前工厂产能是不是满产满销的状态？电子电路铜

箔目前都供给了谁？份额有没有提升？

尊敬的投资者，目前公司在产产能满产满销。电子电路铜箔主要供应生益、胜宏、台光、联茂、松下、ISOLA 等头部企业，目前市场供货份额正稳步提升。感谢您的关注！

10、请问 HVLP 产品现在是否已经开始给相关公司供货？

尊敬的投资者，您好。公司 RTF-3 及 HVLP-1/2 产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4 产品同步推进送样测试。感谢您的关注与支持！

11、公司 HVLP 铜箔的核心技术优势是什么？主要面向哪些应用场景？公司 HVLP 铜箔的核心技术优势是什么？主要面向哪些应用场景？

尊敬的投资者，您好。目前公司 HVLP 等新产品已逐步通过部分下游客户的认证，实际订单将随算力服务器、高端智能装备等终端需求放量逐步释放。未来，随着公司高附加值产品出货量的增加，将为公司带来更多的盈利增长点。感谢您的关注与支持！

12、贵公司未来会把总部变迁深圳吗

尊敬的投资者，您好。公司注册地址位于吉林省长春市，公司于 1997 年在上交所主板上市，目前办公地址位于广东省深圳市。感谢您的关注！

13、目前 pcb 铜箔火爆，利润较高，而 pcb 铜箔公司起步较晚，仍在侧重锂电铜箔，在 pcb 铜箔方面已经远远落后于同行德福科技和铜冠铜箔，更加在净利润和公司市值方面处于行业双倒数第一位置，体现出公司战略和决策存在落后于同行的局面，公司如何摆脱这种倒数落后局面？如何成为所谓的领导者？公司是老牌铜箔公司，第一家铜箔上市公司却沦为市值净利双倒数，反映出公司治理严重落后，如何解决困境，有何规划？

尊敬的投资者，您好。公司 1992 年起开始生产 PCB 铜箔，2003 年公司“高档锂电池用电子材料”项目列入国家“863 计划”，2005 年公司

“高档锂电池用电子材料”项目国家科技部《2005 年国家火炬计划项目》，并非您所言的起步较晚。侧重锂电铜箔的印象系来源于在锂电池刚开始发展之初，公司是当时为数不多的具备批量供货能力的铜箔企业，为市场所熟知。公司坚持使用国产设备、国产添加剂自研高端标箔的生产技术，目前已相继攻克了 HVLP1-4 代的产品，产品已陆续得到客户的认证通过；HVLP-5 代的产品也在开发中。公司一季度净利率较低的原因系因为一季度的稼动率约为 80%；公司二季度的稼动率目前已达到在产产能的 100%，且随着公司技改产能和新产能的不断释放，公司的月度出货量将不断提升，切实将毛利优势转换为净利率提升，高端标箔订单的逐步放量也将有效提升公司的盈利能力。感谢您对公司的关心和期待，公司全体上下将持续奋进，抓住这轮难能可贵的产业升级机会。

14、人工智能发展如火如荼，贵公司铜箔如何实现大发展呢

尊敬的投资者，您好。依托人工智能产业高速发展，公司自主研发的高频低损耗高端电子电路铜箔放量，深耕算力服务器、高端主板等领域。公司未来将持续加码高端新品研发，拓宽优质头部客户资源，稳步提升高附加值产品占比，紧抓算力产业红利，打开业绩增长新空间。感谢您的关注。

15、尊敬的陈董事长，请问证券会对诺德股份的违规信息披露立案调查出结果了吗？另外公司的产能有多少为电子电路铜箔准备，现在电子电路铜箔产能有多少？铜箔产品现在加工费比去年同期提高多少了？

尊敬的投资者，您好。公司目前尚未收到关于立案调查的处理结果，具体进展请关注公司公告。公司提前布局了 3 万吨高端电子电路铜箔的产能。铜箔产品现在加工费比去年同期提升了约 15%。感谢您的关注！

16、贵公司有与英伟达相关业务合作吗？未来公司在高端电子铜箔领域是否有进一步的突破和提升？目前电子高端电子铜箔需求爆发，英伟达 rubin 框架应用 pcb 需求也是大幅提升，贵司对该领域有何估量？

尊敬的投资者，您好。英伟达非铜箔产品的直接客户，系高性能电子

电路铜箔产品的终端客户。公司与英伟达的技术研发部门保持接洽和技术交流。英伟达并不直接对铜箔产品进行认证，公司针对英伟达的产品认证需经过中间客户的认证取得。公司目前部分产品已通过此类中间客户的测试和认证。感谢您的关注！

17、超 400 亿订单！诺德股份与中创新航签订《2026-2028 年保供框架协议》。这个合同执行情况如何，价格是随行就市吗。

尊敬的投资者，您好。目前和中创新航的合同执行情况与框架协议约定的进展一致。价格未在协议中进行锁定，采用随行就市的方式进行磋商。感谢您的关注！

18、陈董事长，公司在抢抓高端 pcb 电子铜箔国产替代方面有何实际举措，目前产品和验证落地情况如何？后续在高端 pcb 电子铜箔方面是否有扩产计划？

尊敬的投资者，您好。公司提前布局了 3 万吨高端电子电路铜箔的产能。目前产品正陆续通过客户的验证，HVL P1-3 代产品已取得月均百吨级订单，HVL P-4 的产品正在客户测试中。目前公司在高端标箔的产能布局充分，短期内都不需要扩产。感谢您的关注！

19、针对公司盈利能力在整个五大铜箔上市公司：诺德股份，德福科技，铜冠铜箔，嘉元科技，中一科技中处于倒数的困境，公司如何才能赶超和持平，有何举措？

尊敬的投资者，您好。公司具备极薄铜箔、高端电子电路铜箔技术与客户优势。后续将持续优化产品结构，全力释放高毛利产品，提升优质产品产能、严控各项成本，同时拓展高端算力与海外优质订单，加快盈利修复，逐步追赶并持平行业同行盈利水平。感谢您的关注。

20、HVL P 的核心优势在于极低的表面粗糙度 ($R_z < 1.5\mu\text{m}$)，可显著降低高频信号传输损耗，适用于 5G 通信、服务器等超高速场景。贵公司的这个产品发展到几代了呢，供应情况如何呢

尊敬的投资者，您好。公司目前 HVL P-4 的产品已在客户处测试。感

感谢您的关注！

21、Q3 电子电路铜箔占比 40 的目标能否如期达成？

尊敬的投资者，您好。公司 Q3 的总产能预计将超过 16 万吨，其中高端电子电路铜箔的产能为 3 万吨。感谢您的关注。

22、董事长您好，我有四个问题

1、请问对于贵公司存贷双高问题是怎么解决的呢

2、贵公司的立案调查处理到哪一步了，结案还需要多久呢？

3、HVLP-4 预计今年产能如何，良率怎么样。

4、HVLP-5 研发到了何种程度了

尊敬的投资者，您好。

1、公司需要自垫现金购买原材料铜，在产品交付后也要承担下游客户较长的支付账期。因此公司所处的行业需要大量的现金进行流转，所以因行业属性影响，公司同业的均具有存贷双高的现象。

2、结案的时间请关注公司公告。

3、HVLP-4 目前正在客户测试阶段。

4、HVLP-5 尚在开发阶段。感谢您的关注！

23、目前市场普遍认为公司在高端 pcb 电子铜箔方面仍处于 HVLP-1/2 低端产品小批量量产，而同行 HVLP-3/4 产品已经实现量产供货，落后两个代差，这也是目前公司估值最被低估的主要原因，请问公司如何破局？有何切实举措？

尊敬的投资者，您好。公司目前正加紧推进 HVLP-4 产品在客户的测试验证。感谢您的关注。

24、董事长好，镀镍合金箔已与头部客户量产合作，具体是哪些客户？月出货量多少？

尊敬的投资者，您好。受保密协议约束，公司无法披露客户情况。目前镀镍合金箔的月出货量尚不多，未来将随着客户硫化物固态电池的产量提升逐步提升。感谢您的关注。

25、随着智能仿生设备应用场景不断拓展，对电池性能提出更高要求，公司产品是否能够满足市场

尊敬的投资者，您好。目前公司 HVLP 等新产品已逐步通过部分下游客户的认证，公司 RTF-3 及 HVLP-1/2 产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4 产品同步推进送样测试，实际订单将随算力服务器、高端智能装备等终端需求放量逐步释放。未来，随着公司高附加值产品出货量的增加，将为公司带来更多的盈利增长点。感谢您的关注与支持！

26、应用与 PCB 的 HVLP-4 的产品什么时间可以量产

尊敬的投资者，您好。公司目前具备量产能力，产品正在客户测试过程中。感谢您的关注！

27、诺德股份一季度毛利率达 11.71%，但是净利率只有 1.66%，净利率低于铜箔头部公司，这是什么原因？二季度有什么改善措施？

尊敬的投资者，您好。公司一季度的稼动率尚未达到满产满销，约为 80%。截至 2026 年 5 月，公司的稼动率已打满。目前公司在手订单充足，随着后续技改和新建产能的投放，出货量还将持续提升。感谢您的关注！

28、公司海外布局进展到哪一步了？目前海外订单占比大概多少？

尊敬的投资者，您好。公司秉承“海内外双循环”的发展模式，以国内技术研发为支撑，海外基地为支点，持续完善全球供应链网络，提升对海外客户的供应链保障能力。公司已与 Isola 建立高端标箔的出口业务，并积极推进包含松下、斗山、SK、三星等海外客户的高端标箔产品的送样和导入。未来，公司将稳步提升国内产能、加速技术迭代与推进全球化战略，抢占新能源产业链的高端市场，以技术整合提升国际竞争力。感谢您

的关注与支持!

29、请问公司在载体铜箔方面有布局吗

尊敬的投资者，您好。公司于 2025 年 10 月 25 日电子铜箔新品发布会上发布了易剥离型极薄载体铜箔产品。

目前，公司已顺利完成易剥离型极薄载体铜箔核心技术研发，现阶段在给头部客户进行送样测试。该产品主要适配 FCBGA 高端封装基板、Chiplet 芯片互联等前沿先进封装领域，可助力高频 PCB 实现载板级超精细线路制作，精准匹配高端芯片高密度互联、高频高速的市场应用需求。目前相关产能建设正有序规划推进，后续将根据市场需求稳步释放产能。感谢您的关注!

30、请问公司 HVLP-1/2 铜箔批量出货了吗？后续的推广计划，市场预期如何？HVLP-3/4 送检测进度如何？预期今年的进度及出货计划如何？

尊敬的投资者，您好。公司 RTF-3 及 HVLP-1/2 产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4 产品同步推进送样测试，未来将切入算力服务器、高端智能装备等高端电子领域供应链。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端 PCB 等多元化应用领域。感谢您的关注与支持!

31、贵公司如何缩短与铜冠铜箔、德福科技等公司的市值差异呢

尊敬的投资者，您好! 公司股价受宏观经济形势、行业发展趋势、投资者偏好和预期等多重因素影响。公司目前经营状况良好，与各客户的合作顺利推进，市场份额保持平稳。公司将努力提升经营管理水平，合理平衡自身长远发展和股东回报，致力于为股东创造长期价值。感谢您对公司的关注与支持。

32、董事长好！动力锂电池新国标 7 月 1 日实施，对公司产品结构、

生产经营的影响？

尊敬的投资者，您好。7月实施的动力电池新国标大幅提升安全与性能标准，将推动行业加速向高端超薄铜箔升级。公司高抗拉、高性能铜箔产品高度契合新规要求，利于优化产品结构，提升高端产品占比，进一步巩固客户资源与市场优势，整体经营迎来积极利好。感谢您的关注。

33、作为智能算力服务器、光模块、6G通信、卫星互联网、自动驾驶等领域的核心刚需材料，高端电子电路铜箔正迎来量价齐升的历史性机遇，行业景气度攀升至新高。贵公司的HVLP-4铜箔生产销售情况如何呢

尊敬的投资者，您好。公司RTF-3及HVLP-1/2产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4产品同步推进送样测试，目前公司HVLP等新产品已逐步通过部分下游客户的认证，实际订单将随算力服务器、高端智能装备等终端需求放量逐步释放。未来，随着公司高附加值产品出货量的增加，将为公司带来更多的盈利增长点。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端PCB等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！

34、HVLP产品发展到几代了呢，通过那些厂家的认证了呢呢

尊敬的投资者，您好。公司RTF-3及HVLP-1/2产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4产品同步推进送样测试，未来将切入算力服务器、高端智能装备等高端电子领域供应链。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端PCB等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！

35、镀镍合金箔已与头部客户量产合作，具体是哪些客户？月出货量多少？

尊敬的投资者，您好。受保密协议约束，公司无法披露客户情况。目

前镀镍合金箔的月出货量尚不多。未来将随着客户硫化物固态电池的产量提升逐步提升。感谢您的关注！

36、贵公司如何利用算力科技大发展的机会，贵公司如何借助这个机会提升市值和业绩呢

尊敬的投资者，您好。公司将紧抓算力爆发、全固态电池技术商业化的政策与市场红利窗口期，以高端铜箔、复合铜箔两大方向为核心重点，加速高端铜箔业务的研发突破与市场开拓，同时持续完善复合铜箔技术储备与前瞻布局，筑牢“双箔驱动”战略的技术护城河，以优异的经营成果回报投资者的信任，致力于实现公司价值与股东利益的共同提升。感谢您的关注。

37、贵公司的铜箔 HVLP 产品现阶段生产销售情况如何，主要供给那个厂家呢

尊敬的投资者，您好。公司 RTF-3 及 HVLP-1/2 产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4 产品同步推进送样测试，未来将切入算力服务器、高端智能装备等高端电子领域供应链。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端 PCB 等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！

38、目前公司的极薄铜箔的产能、销量如何？目前市场占有率如何？后续预期进展如何？铜价上涨，锂电铜箔能保持盈利吗？

尊敬的投资者，截至今年一季度末公司超薄锂电铜箔产销均为 2 万吨，高端产品价格超过普通产品 15%以上，量价向好，超薄品类市场份额稳居行业前列。下半年动力电池与储能需求回暖，行业景气度上行，公司将持续释放高端产能，加快极薄铜箔及新型集流体产品推广，紧抓市场机遇稳固领先铜箔企业优势。感谢您的关注。

39、请问公司今年以来的超薄锂电铜箔产量、销量、价格、市场占比如何？下半年的前景和规划如何？

尊敬的投资者，截至今年一季度末公司超薄锂电铜箔产销均为 2 万吨，高端产品价格超过普通产品 15%以上，量价向好，超薄品类市场份额稳居行业前列。下半年动力电池与储能需求回暖，行业景气度上行，公司将持续释放高端产能，加快极薄铜箔及新型集流体产品推广，紧抓市场机遇稳固领先铜箔企业优势。感谢您的关注。

40、请问公司今年以来，截至目前 HVLP-1/2/3/4 铜箔的产量、销量如何？上半年和下半年的前景和规划如何？

尊敬的投资者，您好。公司 RTF-3 及 HVLP-1/2 产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4 产品同步推进送样测试，未来将切入算力服务器、高端智能装备等高端电子领域供应链。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端 PCB 等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！

41、再获年度订单！诺德股份与国轩高科签订 18 亿元铜箔采购框架协议合同，这个合同不需要公告吗？执行情况如何呢

尊敬的投资者，您好。国轩高科的订单未达到公告标准，属于自愿性披露的范畴。国轩高科的订单目前按照合约进度切实执行。感谢您的关注。

42、公司股价波动厉害，是否有市值管理相关计划？

尊敬的投资者，您好。公司始终认为，专注研发、扎实经营是提升市值的根本。只有持续深耕技术突破、做好主业经营，才能夯实公司价值基础，进而实现市值的长期稳健增长。公司将继续坚持这一理念，以优异的经营成果回报投资者的信任，致力于实现公司价值与股东利益的共同提升。感谢您的关注。

43、铜价涨价对公司业绩影响大吗

尊敬的投资者，您好。公司的产品定价采用 M-1 的月铜均价+加工费的模式，铜价的波动公司可以传导到下游客户。但铜价如果波动过快过大，公司也会受到波动的影响。感谢您的关注。

44、贵公司如何做市值管理，贵公司市值相比较而言，太低了

尊敬的投资者，您好。公司始终认为，专注研发、扎实经营是提升市值的根本。只有持续深耕技术突破、做好主业经营，才能夯实公司价值基础，进而实现市值的长期稳健增长。公司将继续坚持这一理念，以优异的经营成果回报投资者的信任，致力于实现公司价值与股东利益的共同提升。感谢您的关注。

45、贵公司有多少个生产基地呢，高端铜箔占比大吗

尊敬的投资者，您好。公司在国内的四大铜箔基地（广东惠州、青海西宁、湖北黄石、江西贵溪）均实现稳定量产，高端锂电箔占比超70%以上，目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端PCB等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！

46、贵公司会不会回购股票呢

尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理工作，通过多措并举创新投资者关系管理，助力公司价值高效传递。同时，公司始终坚守信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性原则，持续优化以投资者需求为导向的披露体系。为维护全体股东利益，增强投资者信心，公司2024年已完成5,007.566万元回购。公司股价受宏观经济环境、行业政策、市场资金等多重因素影响，公司将持续优化产业链布局、强化经营提质，并进一步加强市值管理工作，促进公司市值合理反映内在价值，以实际行动维护全体投资者长远利益。感谢您对公司的关注！

47、公司HVLP-4的量产能力及订单进展如何？

尊敬的投资者，您好。公司提前布局了3万吨高端标箔的产能，均可用于生产HVLP-4的产品。目前HVLP-4的产品在客户测试验证的过程中。目前公司HVLP等新产品已逐步通过部分下游客户的认证，实际订单将随算力服务器、高端智能装备等终端需求放量逐步释放。未来，随着公司高附加值产品出货量的增加，将为公司带来更多的盈利增长点。感谢您的关注与支持！

48、董事长好，镀镍合金箔已与头部客户量产合作，具体是哪些客户？

月出货量多少

尊敬的投资者，您好。受保密协议约束，公司无法披露客户情况。目前镀镍合金箔的月出货量尚不多。未来将随着客户硫化物固态电池的产量提升逐步提升。感谢您的关注！

49、贵公司现阶段铜箔产能是满产满销吗？贵公司今年提价几回了呢

尊敬的投资者，您好。目前公司5月的订单排产已突破10000吨，在产产能满产满销。目前公司在手订单充足，随着公司技改和新建的产能逐步落地，公司的月出货量将不断突破。公司的产品定价将随着市场供需变化及时变化。感谢您的关注！

50、高性能电子电路铜箔实现量产没有？占比多少

尊敬的投资者，您好。公司RTF-3及HVLP-1/2产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4产品同步推进送样测试，未来将切入算力服务器、高端智能装备等高端电子领域供应链。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端PCB等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！

51、请问陈董事长公司的产品已通过英伟达的认证并批量生产了吗

尊敬的投资者，您好。英伟达非铜箔产品的直接客户，系高性能电子铜箔产品的终端客户。公司与英伟达的技术研发部门保持接洽和技术交流。英伟达并不直接对铜箔产品进行认证，公司针对英伟达的产品认证需经过中间客户的认证取得。公司目前部分产品已通过此类中间客户的测试和认证。感谢您的关注！

52、在高性能电子铜箔方面有哪些具体进展？比如品种和产量？认证情况？

尊敬的投资者，您好。公司RTF-3及HVLP-1/2产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4产品同步推进送样测试，未来将切入算力服务器、高端智能装备等高端电子领域供应链。目前，公司高附加值产品如超高抗超高延、高端电子标箔等的订单量稳步上升，订单情况

	较为饱满，业务覆盖动力电池、储能、消费电子、高端 PCB 等多元化应用领域。感谢您的关注与支持！
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 5 月 19 日